

【Causes/processes involved/keys to judgment】

The defect is caused by the presence of a foreign object preventing solder coating on a part of terminations before HAL process (Before HAL - HAL process)

4-3-2-9 はんだコーティング孔径小／热风整平时孔径变小 / Too small solder coated hole

【特徴】スルーホール内のはんだコーティング厚が厚く、孔径が小さくなっている状態の欠陥

【特征】通孔内の焊料厚度変厚，孔径就变小的缺陷。

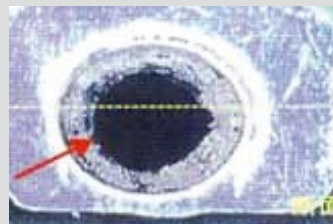
【Characteristics】Excessive solder coating thickness in PTH results in too small a hole size.

【原因・判断ポイント・発生工程】HALのエア圧の低下やはんだ組成の異常などにより出来たもの（HAL工程）

【原因、判断要点、发生工序】HAL的风压下降，或者焊料成分异常等所引起的（HAL工序）。

【Causes/processes involved/keys to judgment】

The defect is caused by a drop of HAL air pressure or anomaly in solder bath composition (HAL process)



【コメント】
顕微鏡倍率 ×

【注釋】
显微镜倍率 ×

【Comments】
Magnification: ×



【コメント】
左スルーホールの断面
顕微鏡倍率 ×

【注釋】
左通孔的截面
显微镜倍率 ×

【Comments】
Left: PTH microsection
Magnification: ×

4-3-2-10 端子間 SR 剥離片はんだ巻き込み／焊料卷入插脚之间的 SR 碎片 / Solder resist debris from between terminals entrapped in solder

【特徴】端子間から剥離した細いSR片がはんだに巻き込まれている状態の欠陥

【特征】焊料卷入从插脚之间剥落的微细SR碎片的缺陷。

【Characteristics】Small solder resist debris peeled off from the gap between terminals is entrapped in coated solder.

【原因・判断ポイント・発生工程】端子間のSRが、HAL工程の熱やエア圧などにより剥離飛散して出来たもの（HAL工程）

【原因、判断要点、发生工序】在HAL工序的热冲击或者风压等作用下，插脚之间的SR剥落并飞溅所引起的（HAL工序）。

【Causes/processes involved/keys to judgment】

Solder resist between terminals are peeled off and splashed onto a neighbouring terminal causing the defect. (HAL process)



【コメント】
顕微鏡倍率 ×

【注釋】
显微镜倍率 ×

【Comments】
Magnification: ×



【コメント】
左写真の拡大
顕微鏡倍率 ×

【注釋】
左照片的截面
显微镜倍率 ×

【Comments】
Enlargement of left photo
Magnification: ×